

2009年5月11日
新日本無線株式会社
ユー・エム・シー・ジャパン株式会社

報道機関各位

新日本無線とユー・エム・シー・ジャパン、半導体製造前工程の生産協業で合意

新日本無線株式会社（以下、新日本無線）とユー・エム・シー・ジャパン株式会社（以下、UMCJ）は、半導体製造前工程（ウェファープロセス）での生産協業を行うことで合意しました。

生産協業の内容は、UMCJの8インチ0.35ミクロンCMOSプロセスをベースに、新日本無線のBCDプロセスを移植するもので、素子設計を主に新日本無線が行い、プロセス設計をUMCJが行います。新日本無線は、完成した0.35ミクロンBCDプロセスのTEGから、設計に必要なPDK（プロセス・デザイン・キット）を準備し、このプロセスを用いてパワーデバイス、オートモーティブ用ICを設計、量産、販売します。さらにUMCJには0.18ミクロンのCMOSプロセスもあり、0.35ミクロンBCDプロセスの0.18ミクロンプロセスへの移行も視野に入れます。

新日本無線は、パワーデバイス、オートモーティブ用IC分野進出のための製品設計の準備が整ってきたことから、従来からデジタルICやLCDドライバーICの生産において取引のあるUMCJと生産協業の話し合いを進め、基本合意に至りました。今後、契約を締結する予定です。

UMCJと新日本無線のパートナーシップは、一般的なファウンドリーサービスを越えた協業となります。これは、UMCJの柔軟性の高いファウンドリーモデルが、お客様のニーズに対応したソリューションを有効に提供できる証となります。

新日本無線は、生産協業分野の製品の設計力強化を川越製作所および北九州デザインセンター（北九州学術研究都市）で行っています。この分野のビジネス規模は、OPアンプ、電源IC、オーディオIC、ビデオICなどの、現在、主力のアナログIC製品以上のものを狙います。現在の前工程は川越製作所および子会社である株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡にあり、主力のアナログICを生産しています。近い将来、これに加えてパワーデバイス、オートモーティブ用ICをUMCJで生産することになります。この外にも、UMCJではチップ面積の大きいCMOSアナログICも生産する計画です。このような生産協業に向けて、新日本無線は4月に組織体制強化を実施し、専任の商品企画部門、IC設計部門、素子開発部門を構築しました。

【新日本無線株式会社について】

新日本無線グループは、アナログ半導体を中心に、設計・開発、製造、販売までをグループで一貫して手掛け、主力製品であるオペアンプは世界トップクラスの販売数量を誇ります。その他レーダー用電子管や衛星通信用コンポーネント製品等マイクロ波を利用した独自製品も製造、販売しています。半導体集積回路の高機能・高集積化が求められ、無線通信における高速・大容量化が進む中、独創的マイクロエレクトロニクスとマイクロウェーブ技術を軸とした最適部品の提供を通して社会価値の向上を目指します。新日本無線株式会社の詳細情報については、Webサイトをご覧ください。[\(http://www.njr.co.jp/\)](http://www.njr.co.jp/)

【ユー・エム・シー・ジャパン株式会社について】

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社は、台湾UMC社のグループの一員として、日本国内に8インチ半導体工場を有している日本初のファウンドリー専門メーカーです。半導体前工程の受託製造事業に特化することで、自社製品を持たず中立的な立場で顧客と競合することなく、あらゆる半導体製造に確かな技術とノウハウを幅広く提供します。

UMC Jの詳細情報については、Webサイトをご覧ください。[\(http://www.umc.j.com/\)](http://www.umc.j.com/)

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

新日本無線株式会社 半導体販売事業部 広告企画部
電話：049-278-1497

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社 広報室
電話：03-5294-2701

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

新日本無線株式会社 半導体販売事業部 営業企画部
電話：03-5642-8233

ユー・エム・シー・ジャパン株式会社 営業部
電話：03-5294-2701